

Compression Molding System

Model PMC2030



PMC2030-D

**The ultimate compression molding system
pursuing market needs**

市場ニーズを追求した 究極のコンプレッションモルディング装置

製品情報



日本語

- 高精度プレスによるパッケージ厚み精度の向上
- 1 台の装置で顆粒／液状樹脂に対応
- ヒートシンク／メタルシールドを露出した状態で基板との同時成形可能
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



PMC2030-D



PMC2030-S



PMC2030-D HS

SPECIFICATION

Items		Unit	Description								
モデル		—	PMC2030-S			PMC2030-D			PMC2030-D HS		
ワークタイプ		—	基板・リードフレーム								
ワークサイズ	長さ	mm	130—300			130—300			220—260		
	幅	mm	50—100			50—100			50—100		
樹脂		—	顆粒・液状			顆粒・液状			顆粒		
マシンタイム		sec	Approximately 43			Approximately 43			Approximately 60		
外形寸法	プレス数	module	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	幅	mm	3,660	4,300	4,940	3,660	4,300	4,940	4,760	5,400	6,040
	奥行き	mm	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705
	高さ	mm	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
重量		ton	4.7	6.4	8.1	4.8	6.6	8.4	5.8	7.6	9.4
成形取り数		workpiece	1	2	3	2	4	6	2	4	6
マガジンスペース		mm	540								
クランプ出力		kN／(tf)	29.4—343.0／3.0—35.0								
クランプ速度		mm／sec	100 (Max.)			50 (Max.)			50 (Max.)		
品種切替え方式		—	キット交換式								
リリースフィルム幅		mm	160 (Max.)								
ヒートシンク・メタルシールドサイズ		mm	—			—			44—94 (W) × 200—253 (L)		

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法は顆粒樹脂仕様の数値を記載しています。

TOWA株式会社

本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ